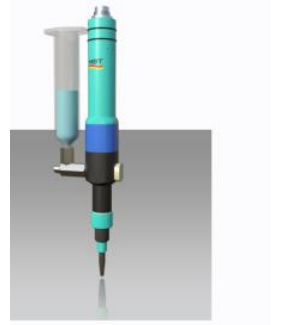


EHD-JETTING · BERÜHRUNGSLOSE MIKRODOSIERUNG

Wo Kontaktverfahren an Grenzen stoßen.

Ein elektrisches Feld zieht den Tropfen aus der Kapillare – ohne Düsenkontakt, ohne Druckluftstoß. Für Mikroelektronik, Optik, Biochips und Spezialanwendungen mit Strukturen, die Piezo- und Schraubsysteme nicht mehr auflösen.



0,08 mm

Dot-Durchmesser

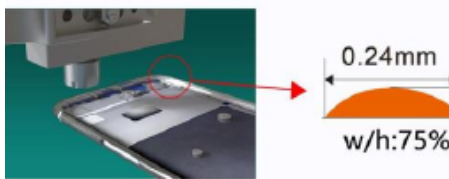
< 0,20 mm

Linienbreite

±1 %

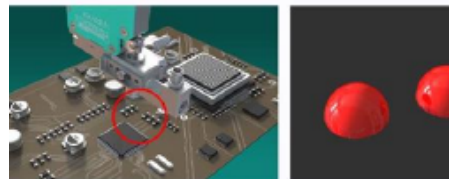
Dosierkonsistenz

ANWENDUNGEN AUS DER SERIE



Smartphone-Mittelrahmen

Hotmelt · feine Linie, automatische Hubanpassung



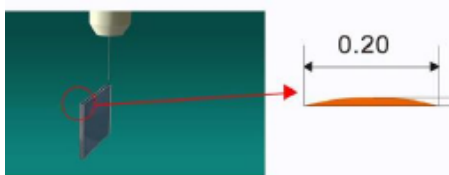
SMT-Chip

SMT-Rotkleber · Punkte unter 0,2 mm



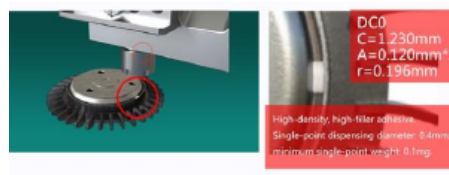
Halbleiter-IC

Silberleitklebstoff · reproduzierbare Geometrie



Linienrand

EHD · Lichtschutzklebstoff, 0,02 mm hoch



Motorbaugruppe

UV-Klebstoff · hochgefülltes Medium



Batterie

Spray / Versiegelung

MATERIALSPEKTRUM

Hotmelt, SMT-Kleber, Silberleit- und Epoxidharzklebstoffe, UV-Systeme, Beschichtungen und Versiegelungen – von 1 bis 200.000 cP.

WAS SAS DAZU LEISTET

Klebstoffauswahl, Laborvalidierung und Automatisierungskonzept aus einer Hand – inklusive Roboter- oder Achsintegration und DIN-2304-konformer Prozessdokumentation.

Bereit für den nächsten Dosierschritt?

Applikationsmuster auf Ihrem Bauteil – schnell, dokumentiert, herstellerunabhängig.

+49 6103 9079983

info@klebstoffloesungen.de